



Tamco 台灣金聯資產管理股份有限公司

北港工業用地

113.12.1~114.1.15 公開標售

說明會





01

標售基本資料

- **土地面積 45,425坪**
 - 甲種工業區 43,560 坪
 - 住宅區 1,318 坪
 - 公共設施用地 547 坪
- **建物面積 794坪**
- **標售底價：新台幣 32.3 億元**
- **投標期間：113/12/01 起 45天**

- 距嘉義科學園區(台積電太保廠) 15km
- 距嘉義高鐵站 17km
- 距國道1嘉義交流道 18km





設廠亮點 具規模經濟工業用地

- 產權單純、面積相當於 11個台北大巨蛋、基地完整方正
- 位於主要交通樞紐，便於物流和資源運輸
- 適合興建廠房自用或進行整體規劃開發，包含部分住宅區用地及建物，可滿足企業員工的居住需求



設廠亮點 土地成本基期低

1 斗南小東工業區

- 交易件數 15件
- 交易面積 20,098坪
- 成交金額 30.7億元
- 成交高價每坪 14~15萬元

資料來源：實價登錄112-113.11

3 斗六工業區

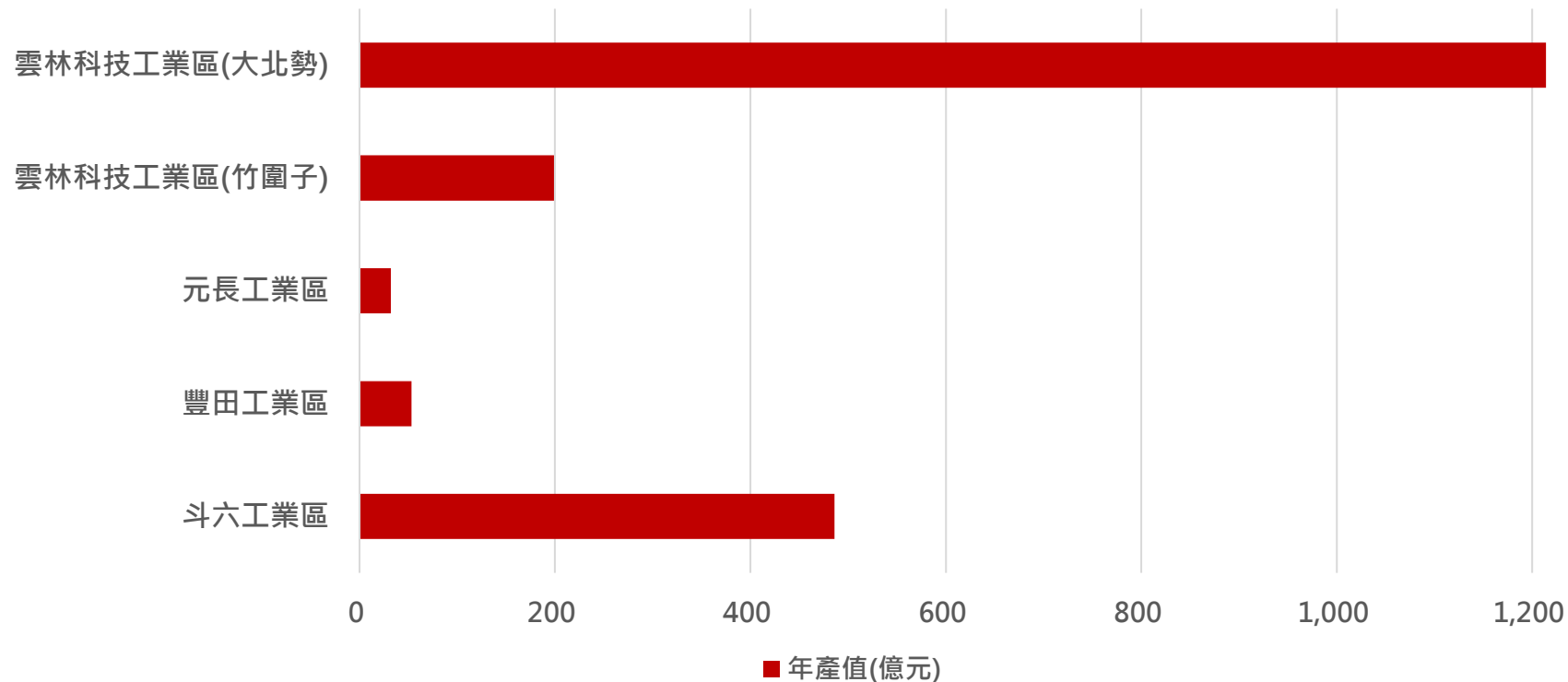
- 交易件數 15件
- 交易面積 1,104坪
- 成交總額 12.5億元
- 成交高價每坪 11~12.5萬元

2 雲林科技工業區

- 交易件數 4件(含113.10矽品)
- 交易面積 18,871坪
- 成交總額 44.34億元
- 成交高價每坪 15~20萬元

設廠亮點 發展當地產業發展

- 位居產業廊帶樞紐，可結合上下游產業進駐，產生聚落效益
- 預估可容納超過 50 家廠商，提供約 2,000 個就業機會，每年創造約 40 億元產值



設廠亮點 具半導體供應鏈進駐潛力

- 矽品精密工業擴廠進駐虎尾園區、新普設廠小東工業區、半導體封裝大廠凌嘉科技設廠雲林土庫
- 嘉義科學園區目前規劃引進台積電先進封裝廠CoWoS與 SoIC等高附加價值的事業
- 北港工業用地距嘉義科學園區15公里，具有潛力成為供應鏈的重要基地，可作為擴廠選址之一



標售達成「三要」目標

1. 繁華地方需要

- 提供2000個工作機會
- 造福1,000個家庭
- 增加住宅需求
- 促進商業活動

2. 發展產業需要

- 位居科技廊道中樞，串聯上中下游廠商，可帶動大北港產業發展

3. 台商擴廠需要

- 隨著台積電、台灣美光、日月光、矽格聯測等半導體擴大布局，滿足供應鏈需求



標售資訊

- **公告標售底價：32.3億元**
- **保證金：1億元**
- **標售期間：113/12/1(日) 至 114/1/15(三)中午12時**
- **開標日期：114/1/15(三) 下午15時**

土地位居中南部科技廊道中樞優勢 適合各產業 歡迎投標設廠



附件附圖

台灣金聯北港工業用地

全區鳥瞰圖



台灣金聯 雲林北港工業用地標售案

開標日期	2025/1/15 15:00
標售底價	32.3 億元
標售土地面積	45,425 坪
甲種工業區土地	43,560 坪
住宅區土地	1,318 坪
公共設施用地	547 坪
標售建物面積 (福利大樓)	794 坪

資料來源：台灣金聯公司

台灣金聯北港工業用地 位置圖



雲林縣工業區 分布概況圖

- 褒忠產業園區
- 麥寮綠色產業科技增值園區
- 麥寮港南公用碼頭加速開發
- 智慧綠色漁業產業園區
- 水產精品增值產業園區



鄰近北港地區 產業分布圖

離島產業園區

電力、煉油、煉鋼、石化科技工業產業

元長產業園區

- 金屬製品製造業
- 食品製造業
- 塑膠製品製造業

嘉義科學園區

- 精密機械、生物科技、光電和電腦周邊

中科虎尾園區

- 電子零組件製造業
- 電腦、電子產品
- 光學製品製造業

雲林產業園區

- 金屬製品製造業
- 橡膠製品製造業
- 電子零組件製造業
- 化學製品製造業

斗六產業園區

食品、金屬、紡織、塑膠產業及觀光工廠

豐田產業園區

- 金屬製品製造業
- 食品製造業
- 塑膠製品製造業



台灣金聯北港工業用地 聯外交通示意圖

